

产品包装变更通知函

一、目的

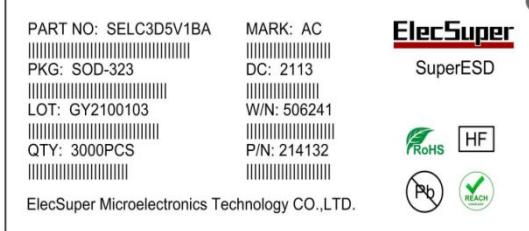
提升产品质量，规范产品包装。

二、变更项目

项目 1：标签

变更内容：

- 1、公司名称、LOGO 变更；
- 2、增加产品 MSL 等级；
- 3、颜色变更。

变更前	变更后
	

项目 2：包装材料

变更内容：所有卷盘出货产品增加铝箔袋、干燥剂、抽真空。

变更前	变更后
	

项目 3：包装数量

变更内容：

15 盘/内盒，变更为 10 盘/内盒。

涉及封装如下：

SOT-143/SOT-23/SOT23-3L/SOT23-5L/SOT23-6L/SOT-323/SOT-353/SOT-363/

SOT-523/SOT-553/SOT-563/SOT-723/SOD323/SOD523/SOD923。

项目 4：内盒、外箱

变更内容：

1、去掉静芯微品牌 LOGO；

2、外箱贴静芯半导体 LOGO 标签。

注：变更后内盒、外箱具体规格以封装厂实际提供为准。

变更前	变更后
	
	



三、变更时间

库存出货按原包装规范执行，新产出回货按新包装规范执行。2025-3-15 开始陆续执行，预计 2026-Q1 全部变更完成。

